# 音波と光干渉を用いた表層欠陥の可視化技術 超音波光探傷装置MAIVIS™(MIV-X)<sup>\*</sup>

児玉 賢治<sup>\*,†</sup>

# Visualizing Technology that Utilizes Sonic Waves and Light Interference to Detect Surface Layer Defects \*

Kenji Kodama<sup>\*,†</sup>

# 1. はじめに

近年,多くの産業分野における製造・整備・保守の現場で は競争力を確保するため、より高いレベルの品質管理や生産 性の向上が求められている.また、表面改質分野においても 多様かつ高度な要求に応えるために新たな素材や加工技術が 開発されている.それらに対応する新たな検査方法も必要と され、とりわけ非破壊での検査ニーズが大きい.

本稿では、試料の表面付近(以下,表層)の欠陥を検知す るのに適し、音波の励振とレーザの干渉光とを組み合わせた 新しい非破壊検査技術(音波光干渉イメージング技術,以下 は本技術)について解説する.また、本技術を実装した当社 の超音波光探傷装置(MIV-X)<sup>1)</sup>を用いた皮膜欠陥に関する 観察事例についても紹介する.

## 2. 音波光干渉イメージング技術の概要

### 2.1 概要

試料に連続した音波振動による外的負荷を加え、試料表面



**Fig.1** Concept diagram of defect detection by visualization of ultrasonic vibration.

を伝搬する音波による微小な面外変形の状況をレーザ照明と 特殊カメラを用いて光学的に可視化し,音波の伝搬が,表層 の亀裂,剥離,空洞などの箇所で変化する様子を観察するこ とにより欠陥を検知する (Fig.1).

#### 2.2 特長

#### 2.2.1多様な形態の表層欠陥を可視化

試料表面の微小な面外変形を光学的に可視化する特殊カメ ラを用いて、カメラ視野内の広域を一括して計測することが できる.表層欠陥の形態による欠陥箇所での音波の伝搬状況 をFig.2に示す.

(a) 露出した母材亀裂:

亀裂箇所で音波の伝搬に不連続が生じる.

(b)皮膜下の母材亀裂:

皮膜表面に露出していない隠れた亀裂欠陥の場合も,(a) と同様に,内部に母材亀裂がある箇所で音波の伝搬に不 連続が生じる.

(c) 接合不良,表面付近の層間剝離など:

塗膜や溶射皮膜などの浮いた箇所では、表面の音波の伝 搬は正常箇所に比べ、振幅大及び波長短と変化が生じる. 薄板部材間の接合不良、ハニカムサンドイッチ構造部材 や建築物などのタイルの接着剝離、CFRPの層間剝離の場 合も同様である.

表面に対する光学的な観察のため, 試料内部の音響イン ピーダンスやX線透過率などの材料特性を考慮することなく 計測できる点も特長である.

#### 2.2.2 計測結果のデータ化が可能

計測結果を画像データとして記録できるため,検査結果の 妥当性を後で検証することが可能になり信頼性向上に寄与で

\* Testing Machines Business Unit, Shimadzu Corporation. (1, Nishinokyo Kuwabara-cho, Nakagyo-ku, Kyoto 604-8511, Japan) † Corresponding author, E-mail : codama@shimadzu.co.jp

<sup>※</sup>原稿受付日 2024年6月10日 ※原稿受付日 2024年6月10日

<sup>※</sup>原稿受理日 2024年6月25日

<sup>\*</sup>株式会社島津製作所 分析計測事業部 試験機ビジネスユニット (〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1)



Fig.2 Acoustic wave propagation at defects.

きる. さらに劣化の経時観察や他手法評価との紐づけなどに も活用が可能となる.

#### 2.2.3 検査作業の効率化に寄与

皮膜で覆われた試料に対し、本技術は皮膜下の欠陥を非破 壊で可視化できるため、従来の浸透探傷検査や磁粉探傷検査 にて必要であった皮膜除去や探傷剤塗布/除去、再塗装など の前後工程を大幅に削減することが可能となる.また、試料 の水浸や遮蔽空間への設置の必要もなく、大型の試料、運用・ 竣工済みの現場においても使用できる可能性がある.

#### 2.3 音波光干渉イメージング技術の原理

連続した音波振動により生じる試料表面の空間的・時間的 な変化に伴う微小な面外変形の測定は,近接した2点からの 反射光を干渉させて面外変形の空間分布を画像化するスペッ クル・シアリング干渉法とストロボスコープ技術を組み合わ せて行う.

#### 2.3.1 音波振動による面外変形の測定

スペックル・シアリング干渉法の光学系の基本構成をFig.3



Fig.3 Optical diagram of a speckle shearing interferometer.

に示す. 試料の表面 (粗面) をレーザ光で照明しカメラで撮影 すると、スペックルとよばれるランダムな明暗パターンの光 学画像 (スペックル像)を取得できる. シアリング干渉法では、 カメラ内部の光学系においてビームスプリッタとミラーを用 いて光路を2分割してわずかに横ずらし (シア:shear) した のちに重ね合わせることで、スペックル像の微分干渉像が得 られる. さらに、2分割した光路の長さを位相シフタで相対的 に変化させながら微分干渉像の各画素の輝度変動を計測する ことにより、各画素に投影されている表面の2点から到来す る光の位相差Δφが求められる.

ここで表面に面外変形が生じると、光位相差 $\Delta \phi$ が変化する.変形前後の光位相差 $\Delta \phi$ b、 $\Delta \phi$ aとレーザの波長 $\lambda$ を用いて、次の関係式より、面外変形による変位のシア方向2点間での空間差分 $\Delta$ z1 –  $\Delta$ z2を算出することができる.

 $(\Delta z1 - \Delta z2) = \lambda (\Delta \phi b - \Delta \phi a) \swarrow 4 \pi$ 

このように、2分割した光路の長さを位相シフタで相対的に 変化させながら微分干渉像の各画素の輝度変動を計測するこ とにより、面外変形による変位のシア方向2点間での空間差 分の二次元分布を求めることができる.

#### 2.3.2 ストロボスコープによる繰り返し現象の観察

音波振動と同期して繰り返し瞬間点灯するストロボスコー プ技術を用いることでレーザ照明による試料表面の近接2点 からの反射干渉光の光位相変化を測定する.ここで,位相シ フタによる複数の光位相,及び異なる複数の音位相の時刻に おいて測定を繰り返すことで,位相時刻の変化に伴う各点の 変位を求めることができる.

#### 2.3.3 音波伝搬の可視化

当社の超音波光探傷装置 (MIV-X) では,各位相時刻にお ける変位量を輝度に換算し,表面の微小な変位の空間 (二次 元)分布をグレースケールで画像化 (以下,音場画像)する (= 空間的変化の可視化). さらに、位相時刻ごとのグレースケー ル画像を用い動画像を構成することで、音波振動による試料 表面の変位を可視化する(=時間的変化の可視化).この可視 化像から、振動状態が空間的・時間的に不連続な箇所を観測 することで、欠陥部を検知することが可能となる.

また、音波伝搬の不連続(音場変状)箇所を画像処理によ り抽出し、試料の映像画像(カメラ画像)と重畳させたオーバー レイ画像を作成する機能を備える.

#### 2.4 JISの制定

本技術を幅広い産業分野における新たな非破壊評価手法と して活用を促すことで、各種現場での作業の効率化、経費節 減などに繋げることが期待できることから、2024年2月に分 析通則としてJISが制定された<sup>2)</sup>.

### 3. 観察事例

#### 3.1 使用装置

皮膜欠陥に関する観察に使用した当社の超音波光探傷装置 (MIV-X)の外観をFig.4に, 仕様をTable 1に示す. 装置は, カメラユニット、制御ユニット、振動子ユニット、ノートPC などから構成される. 撮影画像の解像度の制約から検知可能 な欠陥の最小サイズは撮像範囲の大きさによって変化する. また、近接観察向けに光学ズームセットをオプションとして 準備している.なお、レーザ光はクラス1であり、使用にお いて特別な安全対策の措置は不要である.



Fig.4 System configuration of the MIV-X.

Table 1 Main specifications of the MIV-X

項目	仕 様
試 料 母 材	金属, セラミックス, 複合材など
検知サイズ	撮像範囲のおよそ 1/100 <sup>※</sup> 例えば, 撮影距離 250mm で約 Φ1mm <sup>※</sup>
撮 影 距 離	250~1000mm 光学ズームセット使用時 50~200mm
撮 像 範 囲	100×150 mm (撮影距離 250 mm) 200×300 mm (撮影距離 500 mm) 400×600 mm (撮影距離 1000 mm) 光 学ズームセット使用時 28×42 mm (撮影距離 50 mm)
測定時間	25 秒 以下 **
加振周波数	20k ~ 400kHz
レーザ安全性	JIS C 6802, クラス 1

※代表値であり観察対象や撮影条件により異なる

#### 3.2 皮膜下の母材亀裂

母材に模擬亀裂を設け、表面に塗装を模擬したフィルムを 貼付した鋼板試料をFig.5に示す. 鋼板は外径150 mm, 板厚 20 mmであり、厚さ100 µmのポリエステルフィルムを貼付 した. 模擬亀裂は長さ約11 mm, 幅は最大部約60 µm, 深 さ約3 mm である.

観察結果 (a音場画像, bオーバーレイ画像) を Fig.6 に示す. 亀裂部で明瞭に音場変状を確認でき,フィルム (塗装模擬)下 の欠陥部位を可視化できている.



Fig.5 Steel plate sample with prepared crack.



(a) Acoustic wave image

Fig.6 Crack detection images of steel plate sample.

#### 3.3 溶射皮膜の剥離

アルミ製の基材板に、アルミ・ポリエステル・ケイ素を含 有するパウダーをプラズマ溶射した試料をFig.7に示す. 基材 板は長辺100 mm, 短辺75 mmであり, 溶射材の付着を防ぐ ペーストをMIVの文字型に塗布し、文字がほぼ目視できなく なるまで溶射皮膜を施工した. 平均膜厚は0.257 mmであった.

観察結果をFig.8に示すとおり、MIVの文字をかたどった 音場変状が確認できた. くわえて、X線CT装置による断面 の観察結果をFig.9に示す。音場変状箇所において皮膜と基 材間に空間が確認でき、音場変状と剥離箇所の相関が取れた.



Aluminum plate sample with simulated peeling of thermal Fig.7 spray coating.







**Fig.9** X-ray CT cross-sectional image of the coating peeling area at three vertical lines of the letter M.

本技術は試料のサイズに制約がなく短時間に溶射皮膜の剥離 箇所を検知できる.

### 4. まとめ

本稿で紹介した音波光干渉イメージング技術は,従来手法 では困難な検査を補完する可能性を有した新しい非破壊検査 技術になりえると考えている.表層部分の検査に特化してお り,とりわけ溶射加工面は良好なレーザの反射光が得られ観 察対象として適している.これまでに,サーメット溶射した 部品の出荷検査や,セラミック溶射の加工条件探索などにも 採用された実績がある.さらに音波光干渉イメージングの分 析手法はJISとして制定されたことも踏まえ,幅広い分野で の適用に向けた取り組みを進めている.

#### 文 献

- 1) 堀川浩司, 岡本弘文, 田中隆, 杉本賢, 三品尚登, 早川昌志, 畠堀貴秀, 吉田康紀: 超音波と光を利用した表層欠陥を可視 化する非破壊検査装置 超音波光探傷装置 MAIVIS<sup>TM</sup> MIV-500の開発, 島津評論, 75, pp.95-102 (2021)
- 2) JIS Z2411:2024:音波光干渉イメージング分析通則(2024).